(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-247961 (P2001-247961A)

(43)公開日 平成13年9月14日(2001.9.14)

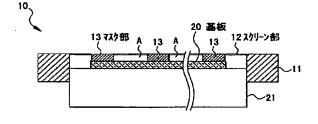
(51) Int.Cl. ⁷	1.7		テーマコート*(参考)	
C 2 3 C 14/24		C 2 3 C 14/24	G 3K007	
14/04		14/04	A 4K029	
H 0 5 B 33/10		H05B 33/10		
33/14		33/14	Α	
		審查請求未請求請求	求項の数8 OL (全 10 頁)	
(21)出願番号	特願2000-60790(P2000-60790)	(71) 出願人 000001443		
		カシオ計算機株式会社		
(22)出願日	平成12年3月6日(2000.3.6)	東京都渋谷区本町1丁目6番2号 (72)発明者 山田 裕康		
		東京都八王	子市石川町2951番地5 カシオ	
		計算機株式	会社八王子研究所内	
		(74)代理人 100090033		
		弁理士 荒	鉛 博司 (外1名)	
		Fターム(参考) 3K007 /	AB18 BA06 CA01 CB01 DA01	
		I	DB03 EB00 FA01	
		4K029	AA09 AA24 BB03 HA02 HA03	
		HA04		

(54) 【発明の名称】 蒸着用スクリーンマスク、蒸着方法及び有機EL素子の製造方法

(57)【要約】

【課題】 高精細なパターニングに対応可能で、コスト 低減に寄与することができる蒸着用スクリーンマスク、 蒸着方法及び有機EL素子の製造方法を提供する。

【解決手段】 磁性材料からなるメッシュ状のスクリーン部12と、該スクリーン部12の下面側に突出するマスク部13と、等からなる蒸着用スクリーンマスク10を用いて、適宜な磁力によりスクリーン部12を基板側に押しつけた状態で、有機EL素子のカソード電極を蒸着により形成する。マスク部13は、乳剤を用いてカソード蒸着パターンAの反転パターンに形成する。マスク部13は、感光性をもつ乳剤から形成されているので、微細パターンの形成が容易であり、カソード蒸着パターンAを微細パターンに蒸着することができる。また、蒸着は、蒸着用スクリーンマスク10を基板に設置することで行うことができ、簡易的である。



30

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に蒸着によりバターニングされた 膜を形成する際にマスクとして用いられる蒸着用スクリ ーンマスクであって、

複数の第1開口部を区画する隔壁を有するマスク部と、各々の開口面積が前記各第1開口部の開口面積より小さい複数の第2開口部を有し、前記複数の第2開口部が前記マスクの前記各第1開口部上に配置される磁性材料を含むメッシュ状のスクリーン部と、

を備えることを特徴とする蒸着用スクリーンマスク。 【請求項2】 請求項1記載の蒸着用スクリーンマスク において、

前記マスク部が、露光及び現像によりパターニングされた感光性材料からなることを特徴とする蒸着用スクリーンマスク

【請求項3】 請求項1記載の蒸着用スクリーンマスクにおいて、

前記マスク部が、スクリーン部にアディティブ法により パターニングされた金属材料からなることを特徴とする 蒸着用スクリーンマスク。

【請求項4】 前記請求項1~3のいずれか一つに記載の蒸着用スクリーンマスクにおいて、

前記スクリーン部は周囲を枠体で覆われ、前記マスク部 は前記スクリーン部により支持されていることを特徴と する蒸着用スクリーンマスク。

【請求項5】 請求項1~4のいずれか一つに記載の蒸 着用スクリーンマスクを用いた蒸着方法であって、

前記蒸着用スクリーンマスクのマスク部が基板に密着するように前記蒸着用スクリーンマスク及び前記基板を配置した後に、

前記基板に対して複数の方向から蒸着材料を照射すると とを特徴とする蒸着方法。

【請求項6】 請求項5記載の蒸着方法において、 蒸着材料を複数の方向から前記基板に照射するために、 前記基板を蒸着材料の照射方向に対して斜めにするとと もに、蒸着材料の照射源に対して前記基板を相対的に回 転させることを特徴とする蒸着方法。

【請求項7】 請求項4記載の蒸着用スクリーンマスクを用いた蒸着方法であって、

前記蒸着用スクリーンマスクのマスク部が基板に密着す 40 るように蒸着用スクリーンマスクのスクリーン部を磁力 により基板側に押しつけた状態で、蒸着を行うことを特 徴とする蒸着方法。

【請求項8】 請求項5~7のいずれか一つに記載の蒸着方法を用い、基板上に少なくとも第一電極と有機EL層と第二電極とが形成された有機EL素子の製造方法であって、

基板上に第一電極と有機EL層とを形成した後に、前記 蒸着方法を用いてバターニングされた第二電極を形成す ることを特徴とする有機EL素子の製造方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高精細なパターニングが可能な蒸着用スクリーンマスク、蒸着方法及び有機EL素子の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、有機EL素子(エレクトロルミネッセンス素子)としては、例えば、ガラス基板上にインジウムースズ酸化物(ITO)からなる透明電極(アノード電極)と、ホール輸送層や発光層および電子輸送層等からなる有機EL層と、背面電極(カソード電極)と、等を積層したものが知られている。有機EL素子は、例えば、電圧を印加したときに電流が流れ、アノード電極から注入されたホールとカソード電極から注入された電子とが、有機EL層で再結合し蛍光色素などを励起するととで、発光可能な素子である。

【0003】カソード電極は、例えば、低仕事関数の金属などからなり、蒸着などの方法で形成することができる。この場合にカソード電極は、例えば、有機EL層に20 積層して形成される場合があるが、通常、カソード電極の材料は水や酸素に対して弱い材料であるために、カソード電極をパターニングする場合にはフォトリソグラフィなどの方法を適用することは難しい。そこで、基板表面のカソード電極パターンの間の部分を覆う形状とされたメタルマスクを用いて、カソード電極を蒸着により形成することが知られている。

【0004】また、高精細なカソード電極パターンを形成するために、周知のレジスト材料などにより、基板側に、カソード電極パターンに合わせた隔壁を設けて、カソード電極を蒸着する場合がある。この場合には、メタルマスクは、単に、蒸着する面の全面に渡って開口した窓を備える形状とすれば良い。また、隔壁の基板に起立する側面は、例えば、逆テーパ形状に形成しておくことで、カソード電極を蒸着したときに、隣接するカソード電極パターンが絶縁分離される。この場合の隔壁は、レジスト材料により微細加工が可能であるので、メタルマスクを用いる場合と比較して、高精細なカソード電極パターンを形成することが可能となる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、例えば、単純マトリックス方式駆動またはTFTをスイッチング素子に用いたアクティブマトリクス駆動で画像表示が可能な有機EL素子のカソード電極は、そのパターンの幅が、有機EL素子の発光領域幅にほぼ等しくなるために、高精細なパターニングが要求されることがある。しかしながら、メタルマスクを用いて、有機ELで要求される高精細パターンを形成することは困難であった。また、上述のような隔壁を基板側に形成する場合には、高精細なカソード電極パターンを形成することができる

50 が、隔壁を形成するためのレジスト材料の塗布工程や、

塗布したレジスト材料から所定の形状の隔壁を形成するフォトリソグラフィ工程などが必要とされ、有機EL素子の製造コストが増加しやすいものとなっていた。

【0006】本発明の課題は、高精細なパターニングに対応可能で、コスト低減に寄与することができる蒸着用スクリーンマスク、蒸着方法及び有機EL素子の製造方法を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】以上の課題を解決するため、請求項1記載の蒸着用スクリーンマスクは、例えば、図1、2に示すように、基板20上に蒸着によりバターニングされた膜を形成する際にマスクとして用いられる蒸着用スクリーンマスク10であって、複数の第1開口部を区画する隔壁を有するマスク部13と、各々の開口面積が前記各第1開口部の開口面積より小さい複数の第2開口部を有し、前記第2開口部が前記マスクの前記第1開口部上に配置される磁性材料を含むメッシュ状のスクリーン部12と、を備えることを特徴とする。

【0008】請求項1記載の蒸着用スクリーンマスクによれば、スクリーン部が磁性材料を含むので基板上にス 20 クリーンマスクにより所定のパターンの薄膜を蒸着により形成する際に、電磁石を有するステージに基板を載置することでスクリーン部がマスク部の第1開□部及び隔壁を介して基板側に引きつけられるためにマスク部を基板に押しつけることができるのでマスク部と基板との密着性が増し、隔壁と基板の隙間から蒸着材料が入り込むことを防止して高精細な薄膜のパターニングが可能となる。このスクリーンマスクは再利用できるので、蒸着する度にマスク部と同じ形状のマスクをフォトリソ工程により形成する必要がないので低コストで且つ高スループ 30 ットで蒸着を行うことが可能となる。

【0009】また、蒸着材料はマスク部の各第1開口部 及びスクリーン部の第2開口部を介して基板側に蒸着さ れるが、この場合に、スクリーン部と基板との間の距離 (以下、スクリーン-基板間距離)が短い場合には、蒸 着材料を照射しても、蒸着材料がスクリーンの裏面に充 分に回り込むことができずに基板へと到達してしまい、 得られる蒸着膜はスクリーンのメッシュ形状(網目の部 分や網の部分など)を反映して、均一な連続膜が得られ ない場合がある。ととで、上記構成によれば、所望のバ 40 ターニング形状をマスク部の第1開口部により定義した い場合は、マスク部の隔壁の厚さを制御することでスク リーン-基板間距離を保持させ、蒸着材料がスクリーン 部のメッシュの網の部分の裏側に回り込ませることが可 能になる。これにより、蒸着膜を、スクリーン部のメッ シュ形状の第2開口部の影響を受けずに、均一かつ連続 した状態に、好適に、形成することができる。

【0010】また、マスク部は、スクリーン部下面側に 所定の厚さに形成されるので、スクリーン部と基板とが 接触しないように、スクリーン部を支持する役目も担 う。従って、スクリーン-基板間距離は、形成する蒸着 膜の膜厚よりも長く確保することが好ましい。この場合 には、形成された蒸着膜がスクリーン部と接触するなど して、壊されたりすることがない。

【0011】また、マスク部は、基板表面を所定のバターンに蒸着するための形状に形成できれば、その材質は特に限定されない。例えば、露光・現像によりバターン形成可能な感光性を持つ材質とすれば、周知のフォトリソグラフィ技術により、微細バターンも形成が容易である。また、例えば、周知のアディティブ法などにより、スクリーンに金属材料からなるバターンを形成しても良い。

【0012】請求項2記載の蒸着用スクリーンマスクは、請求項1記載の蒸着用スクリーンマスクにおいて、前記マスク部が、露光及び現像によりパターニングされた感光性材料からなることを特徴とする。

【0013】請求項2記載の蒸着用スクリーンマスクによれば、請求項1と同様の効果を奏することができるとともに、マスク部は、感光性材料により形成されていることから、例えば、フォトリソグラフィ技術により、微細なパターンの形成も容易である。ここで、感光性材料としては、所定のパターンに形成することができれば限定されないが、例えば、スクリーン印刷で一般的に用いられる紫外線感光タイプのものを好適に用いることができる。すなわち、ポリビニルアルコールや酢酸ビニルなどの水溶性高分子と、ジアゾニウム塩などの感光性を有する物質と、等を成分として含む感光性エマルジョン(以下、乳剤)や、鉄塩を成分として含むフィルムや、感光性樹脂などが挙げられる。

【0014】また、露光・現像してバターニングされた感光性材料は、通常、ある程度の柔軟性を持っている。従って、蒸着用スクリーンマスクを基板に設置して、マスク部の下面と基板表面とが接触した場合においても、マスク部の柔軟性のために基板表面に好適に密着できるとともに、蒸着面が有機EL層となる場合においても、有機EL層を壊したりすることがない。

【0015】請求項3記載の蒸着用スクリーンマスクは、請求項1記載の蒸着用スクリーンマスクにおいて、例えば、図5に示すように、前記マスク部(メタルマス40 ク41)が、スクリーン部にアディティブ法によりパターニングされた金属材料からなることを特徴とする。【0016】請求項3記載の蒸着用スクリーンマスクによれば、請求項1と同様の効果を奏することができる。また、通常、蒸着の際には、蒸着材料は、加熱されて霧状とされた状態で供給されることになる。従って、蒸着用スクリーンマスクは、ある程度の高温雰囲気(以下、この温度をプロセス温度と称す)におかれることになる。ここで、請求項3の構成によれば、マスク部が金属材料から形成されているので、ある程度の耐熱性を確保50 することができ、蒸着の際のプロセス温度の上限を高く

することができる。従って、蒸着プロセスの余裕度を向 上することができる。

【0017】請求項4記載の蒸着用スクリーンマスク は、前記請求項1~3のいずれか一つに記載の蒸着用ス クリーンマスクにおいて、前記スクリーン部は周囲を枠 体で覆われ、前記マスク部は前記スクリーン部により支 持されていることを特徴とする。

【0018】請求項4記載の蒸着用スクリーンマスクに よれば、請求項1~3と同様の効果を奏することができ るとともに、マスク部はスクリーン部に支持されるの で、マスク部を微細パターンに形成することも容易であ る。また、スクリーン部は、例えば、蒸着用スクリーン マスクの外枠となる枠体を設け、該枠体に張られた状態 で備えるなどして、ある程度の張力が加えられた状態と することが好ましい。この場合には、蒸着用スクリーン マスクに充分な強度を付与することができる。特に、あ る程度の大きさの長い蒸着用スクリーンマスクを形成す るときでも、充分な強度を付与することができる。

【0019】なお、強磁性材料からなるスクリーン部と は、適宜な磁力により基板側に押しつけられる磁性を備 20 を特徴とする。 えていれば、特に限定されるものではない。例えば、磁 性材料から形成されたスクリーン部だけでなく、非磁性 材料 (例えば、テトロン (登録商標) やナイロンなどの 樹脂材料など) からなるスクリーン部の表面を、強磁性 材料を用いてコーティングしたものも含まれる。また、 上記非磁性材料に磁性材料を分散させることで磁性を持 たせた材料から形成されたスクリーン部も含まれる。

【0020】また、この場合には、適宜な磁場をかけた ときに、スクリーン部だけでなくマスク部も基板側に押 しつけられる状態とするように、前記マスク部を形成す る際に、前記マスク部に磁力により吸着可能な物質を含 ませても良い。

【0021】請求項5記載の蒸着方法は、請求項1~4 のいずれか一つに記載の蒸着用スクリーンマスクを用い た蒸着方法であって、例えば、図3に示すように、前記 蒸着用スクリーンマスクのマスク部が基板に密着するよ うに前記蒸着用スクリーンマスク及び前記基板を配置し た後に、例えば、図4に示すように、前記基板に対して 複数の方向から蒸着材料を照射することを特徴とする。

【0022】請求項5記載の蒸着方法によれば、請求項 40 1~4と同様の効果を奏することができる。また、通 常、蒸着の際には、蒸着材料は真空度が高いほど直進性 が高くなるために、真空度が高い条件では、蒸着膜に、 メッシュ形状が反映される場合がある。すなわち、基板 上の、メッシュの網の部分の下方の部分に遮られるよう になるために、この部分に蒸着材料が充分に供給されず に、均一で連続した蒸着膜を形成できない場合があり得 る。ととで、上記構成によれば、蒸着材料が基板に対し て複数の方向から照射されるので、マスク部で仕切られ た蒸着されるべき部分に、蒸着材料を充分に供給すると 50 板上に少なくとも第一電極(アノード電極20a)と有

とができる。従って、蒸着膜が、スクリーンのメッシュ 形状を反映して、孤立したり不連続膜となったりすると とがなく、均一な連続膜を、好適に得ることができる。 また、真空度を低下させることで蒸着材料の直進性を抑 制し、蒸着されるべき部分に蒸着材料が充分に供給され るようにしても良い。

【0023】また、複数の方向から蒸着材料を照射する には、例えば、基板に対して複数の方向に照射源を設け た構成としても良いし、基板側を適宜動かすことで、基 10 板に対して複数の方向から蒸着材料が照射されるような 構成としても良い。また、これらの動作を併用した構成 としても良い。しかし、複数の照射源を設けるよりも、 基板を動かす構成とする方が、簡易に実現できるために 好ましい。

【0024】請求項6記載の蒸着方法は、請求項5記載 の蒸着方法において、蒸着材料を複数の方向から前記基 板に照射するために、前記基板を蒸着材料の照射方向に 対して斜めにするとともに、蒸着材料の照射源(蒸着ボ ート30)に対して前記基板を相対的に回転させること

【0025】請求項6記載の蒸着方法によれば、請求項 5と同様の効果を奏することができる。また、基板を蒸 着材料の照射方向に対して斜めにするとともに、基板 が、蒸着材料の照射源に対して相対的に回転されている ので、蒸着されるべき部分に、蒸着材料が充分に供給す ることができる。従って、好適に、所定のパターンの蒸 着膜を形成することができる。

【0026】との場合に、蒸着材料の照射源に対して基 板を相対的に回転させるとは、基板側を回転させる構成 としても良いし、照射源側を回転させる構成としても良 30 いし、また、これらの構成を併用した構成としても良 い。基板側を回転する構成とする場合には、例えば、基 板を設置するステージを自公転することが好ましい。

【0027】請求項7記載の蒸着方法は、請求項4記載 の蒸着用スクリーンマスクを用いた蒸着方法であって、 前記蒸着用スクリーンマスクのマスク部が基板に密着す るように蒸着用スクリーンマスクのスクリーンを磁力に より基板側に押しつけた状態で、蒸着を行うことを特徴 とする。

【0028】請求項7記載の蒸着方法によれば、請求項 4と同様の効果を奏することができるとともに、磁力に よりスクリーンが基板側に押しつけられることで、マス ク部が基板に密着するようにされているので、所定のバ ターンの蒸着膜を好適に得ることができる。また、マス ク部は基板に密着しているので、マスク部下面と基板と の間に、蒸着材料が入り込むこともなく、蒸着膜が所定 のパターンに形成される。

【0029】請求項8の有機EL素子の製造方法は、請 求項5~7のいずれか一つに記載の蒸着方法を用い、基 機EL層20bと第二電極(カソード電極20c)とが 形成された有機EL素子の製造方法であって、基板上に

第一電極と有機EL層とを形成した後に、前記蒸着方法 を用いてパターニングされた第二電極を形成することを

特徴とする。

【0030】請求項8記載の有機EL素子の製造方法に よれば、請求項5~7と同様の効果を奏することができ る。また、通常、有機EL素子は、有機EL層の上面と 下面に対向するように積層される二つの電極層を備えて いる。そして、例えば、一方がアノード電極とされると 10 ともに、他方がカソード電極とされて、有機EL素子が 駆動される。ことで、上記構成によれば、基板上に第一 電極と有機EL層とを形成した状態で、第二電極のバタ ーンにあわせて形成された、本発明の蒸着用スクリーン マスクを用いて蒸着することで、パターニングされた第 二電極を形成することができる。また、上述のように、 マスク部が基板側に押しつけられているので、基板表面 の蒸着部分のみに蒸着することができる。従って、第二 電極パターン同士が短絡したりすることなく形成すると とができる。従って、上記構成によれば、第二電極がパ 20 ターニングされた有機EL素子を好適に製造することが できる。

[0031]

【発明の実施の形態】 [第1の実施の形態]以下、図1 ~4を参照して、第1の実施の形態の蒸着用スクリーン マスク10を詳細に説明する。第1の実施の形態の蒸着 用スクリーンマスク10は、図2に示すように、例えば 1つの素子当たり8つの有機EL素子のカソード電極バ ターンAの組を蒸着により形成するものである。

【0032】本実施の形態で製造される有機EL素子 は、単純マトリックス方式で駆動され、例えば、ガラス 基板などの透明性をもつ基板20(図4に図示)上に、 互いに隣接するように配置されたストライプ状の多数の アノード電極20a (第一電極、図4に図示)と、該ア ノード電極20aの上面に形成された有機EL層20b (図4に図示)と、該有機EL層20bの上面でアノー ド電極20 aと直交するように配置されたストライプ状 の多数のカソード電極20c(第二電極、図4に図示) と、等から構成されている。上記構成の有機EL素子 は、有機EL層20bを介して互いに直交して配置され 40 るアノード電極20aとカソード電極20cとのいずれ か一方を、単純マトリックス方式で駆動される有機EL 素子の信号電極として用いるとともに、他方を走査電極 として用いることで駆動される。すなわち、信号電極に 所定の電圧を印加した状態で、走査電極に順次電圧を印 加していくことで、信号電極と走査電極との交差部分の 有機EL層20bに印加された電圧に応じて電流が供給 され、この交差部分の有機EL層20bが発光するよう になっている。

8

示すように、基板20の表面にアノード電極20aと有 機EL層20bを所定のパターンに形成した後に、該基 板20に蒸着用スクリーンマスク10を設置した状態 で、カソード電極20cの蒸着を行う。カソード電極の 蒸着は、例えば、蒸着材料を真空下で加熱するととで霧 状にし、霧状となった蒸着材料が蒸着ポート30(図4 に図示)から放出され、基板20の表面に堆積すること でなされる。なお、図3は、アノード電極20aと有機 EL層20bとが配置された部分の断面図を示してお り、図3においては、アノード電極20aと有機EL層 20 bとは、図3における左右方向に延在して配置され るストライプ形状を有している。従って、カソード電極 20cは、アノード電極20aと直交するように、図3 における表側と裏側との方向に延在して配置されるスト ライプ形状に形成することになる。

【0034】カソード電極20cとしては、上述のよう に、低仕事関数の金属などを、好適に用いることができ る。例えば、本実施の形態においては、アルミニウム層 とカルシウム層とからなる二層構成とする。例えば、カ ルシウム層は3.0×10°(m)程度の膜厚とし、アルミニウ ム層は6.0×10⁷ (m)~1.0×10⁶ (m)程度の膜厚とすると とが好ましい。

【0035】蒸着用スクリーンマスク10は、図2に示 すように、蒸着用スクリーンマスク10の外枠となる枠 体11と、該枠体11にテンションをかけて張られた状 態で備えられ、強磁性材料からなるメッシュ状のスクリ ーン部12と、該スクリーン部12の下面側に形成され るとともに、乳剤(例えば、上述の感光性エマルジョ ン)をカソード電極パターンAの反転パターンに形成し 30 たマスク部13と、を主にして構成されている。すなわ ち、複数のストライプ状の開口部 (第1開口部) を隔壁 となる乳剤で区画している。そして、スクリーン部12 は、網目状に開口部(第2開口部)が設けられたメッシ ュとなっており、スクリーン部12の開口部は、マスク 部13の上にも形成され、その各開口面積はマスク部1 3の各開口部の開口面積より小さい。なお、図2におい ては、蒸着用スクリーンマスク10を、基板20に設置 される側から眺めた様子を示している。

【0036】蒸着用スクリーンマスク10の枠体11 は、図1に示すように、電磁石ステージ21に取り付け 可能となっている。電磁石ステージ21は、基板20を 設置できるようになっている。電磁石ステージ21は、 所定の操作によりON/OFFし、蒸着用スクリーンマ スク10を設置した状態で、ON状態とすると、磁性材 料からなるスクリーン部12には磁力が作用して、基板 20側へと押しつけられる。これにより、スクリーン部 12に形成されるマスク部13が基板側へと押しつけら れて、マスク部13の下面と基板20とが密着するよう になっている。このとき、ストライプ状のアノード電極 【0033】従って、本実施の形態においては、図3に 50 20a直上の有機EL層20bと、アノード電極20a

が設けられていない有機EL層20bとには、アノード 電極20 a の厚さにより生じる段差が発生しているが、 乳剤からなるマスク部13は柔軟性に富んでいるので上 下に段差のある有機EL層20aを充分に密着すること ができ、且つ蒸着用スクリーンマスク10を電磁石ステ ージ21に取り付けて、磁力による応力をマスク部13 が吸収するので、下面が有機EL層20aに密着して も、有機EL層を壊したりすることがない。なお、有機 EL層20aの材料としてポリマ有機EL材料は、溶媒 により溶融することができるので湿式成膜することが可 10 能であり、湿式成膜された有機EL層20aはアノード 電極20aの段差をある程度緩衝する作用があるので、 より好適である。

【0037】スクリーン部12の材質は、上述のよう に、電磁石ステージ21の磁力により押しつけられるた めの磁性を持つことと、蒸着の際のプロセス温度の高温 にさらされても、強度が極端に低下したり、熱膨張によ りスクリーン部12に撓みが生じたりすることがないよ うにできれば、適宜選択することができる。例えば、ス テンレスやインバーやスーパーインバー等を好適に用い 20 るととができる。

【0038】また、スクリーン部12の形状は、メッシ a数や開口率 (オープニング) を適宜選択することがで きる。ここで、スクリーン部12となるメッシュとして は、微細なパターンのマスク部13でも確実に支持でき るようなメッシュ数を持つことが好ましく、蒸着材料が 充分に基板20へと照射されるためのオープニングをも つことが好ましい。本実施の形態におけるスクリーン部 12としては、上記の点を考慮したものであれば特に限 定されないが、特に、メッシュ400以下、オープニン 30 グ50%以上の範囲のものを好適に用いることができ る。

【0039】また、マスク部13は、乳剤を用いて、カ ソード電極パターンAの反転パターンに形成されてい る。また、マスク部13は、図1に示すように、スクリ ーン部12から突出した状態に形成されている。マスク 部13は、例えば、周知のフォトリソグラフィ技術を用 いて、露光及び現像によりパターンを形成することがで きる。そして、露光及び現像によりパターンが形成され るので、微細パターンも容易に形成することができる。 【0040】また、マスク部13には、充分なスクリー ン-基板間距離(上述)が確保されるように、充分な厚 さが持たされている。これにより、蒸着の際に、蒸着材 料がスクリーン部12の網の部分の裏面側にも充分に回 り込んで、蒸着膜にスクリーン部12の形状が反映され ることを抑制する。本実施の形態においては、マスク部 13の厚さが2.0×10°(m)以上となるようにパターニン グされたものを、好適に用いることができる。

【0041】次に、本実施の形態の蒸着用スクリーンマ

ッシュ状のスクリーン部12を備えるとともに、該スク リーン部12の下面側に突出するようにマスク部13を 形成する。スクリーン部12は、枠体11にテンション をかけて張った状態にして備える。また、マスク部13 は、周知のフォトリソグラフィ技術により、所定のパタ ーンに形成することができる。

【0042】次に、本実施の形態の蒸着用スクリーンマ スク10を用いて、有機EL素子を製造する方法を説明 する。始めに、基板20上にアノード電極20aを所定 のバターンに形成し、次いで、アノード電極20aの上 面に、有機EL層20bを所定のパターンに形成する。 アノード電極20aは、例えば、蒸着等によりアルミニ ウム、チタン、タングステン、ネオジムまたはクロム等 の金属単体或いはこれらのうちの少なくとも1つを含む 合金やITOのような透明金属等の低抵抗の金属膜など を用いて、例えば、周知のフォトリソグラフィ技術によ りバターン形成することができる。この後、適宜、酸素 プラズマ洗浄などの処理を施した後に、アノード電極2 Oaの上面に、有機EL層20bを形成する。有機EL 層20bは、周知のフォトリソグラフィ技術によりバタ ーン形成することができる。例えば、レジスト材料を用 いて隔壁を形成した後に、隔壁で囲まれる領域に、原材 料となる溶液を流し込む。また、適宜、加熱処理などを 行って固化する。なお、有機EL層20bが、例えば、 ホール輸送層と、発光層と、電子輸送層と、等からなる 場合には、順次、これらの層を所定のバターンで形成す ることになる。

【0043】次いで、この状態で、本実施の形態特有の 蒸着用スクリーンマスク10を用いて、カソード電極バ ターンを蒸着する。始めに、アノード電極20aと有機 EL層20bとが形成された基板20を、電磁石ステー ジ21に設置する。また、蒸着用スクリーンマスク10 を、電磁石ステージ21に取り付ける。この時、電磁石 ステージ21をON状態として、スクリーン部12を磁 力により基板20側に引きつけ、マスク部13の下面を 蒸着面に密着させる。以上により、カソード電極20 c を形成するための準備をする(図3にこの状態を図示す

【0044】この状態で、蒸着材料を加熱して霧状にし て、蒸着ポート30から照射する。この際、基板20を 設置した電磁石ステージ21を、例えば、自公転させ る。これにより、比較的、高真空であっても、スクリー ン部12を介したマスク部13の間の領域に、充分に蒸 着材料が照射され、メッシュのパターンによって蒸着材 料が基板20へと届かなくなることがなく、蒸着膜を、 均一な連続膜とすることができる。なお、蒸着材料が、 基板20へと充分に届くようにするために、真空度を低 くした条件で蒸着しても良い。

【0045】以上の通りにして、カソード電極パターン スク10の製造は、枠体11に、上述の材質からなるメ 50 Aを蒸着により形成する。本実施の形態においては、カ

ソード電極としては、例えば、カルシウム層を3.0×10 - (m)程度の膜厚に蒸着した後に、アルミニウム層を6.0×10 (m)~1.0×10 (m)程度の膜厚に蒸着する。次いで、蒸着用スクリーンマスク10を基板20上から外すことで、マスク部13の反転パターンを有するカソード蒸着パターンAが形成される。以上のようにして、カソード電極パターンAを形成して、有機EL素子を製造することができる。

【0046】以上の第1の実施の形態の蒸着用スクリーンマスク10によれば、マスク部13を乳剤により微細 10パターンに形成することができるので、微細パターンのカソード電極パターンAの形成が容易である。また、マスク部13により充分なスクリーン-基板間距離が確保されるとともに、電磁石ステージ21は自公転されているので、スクリーンのメッシュ形状の影響を受けずに、均一かつ連続した膜として形成することができる。さらに、マスク部13がスクリーン部12と基板20とを離間した状態にするので、形成した蒸着膜と、スクリーンとが接触したりすることがない。従って、アノード電極20aとカソード電極20cと有機EL層20bと等か 20らなる有機EL素子を、好適に、製造することができる。

【0047】また、電磁石ステージ21の磁力により、スクリーン部12が基板側に押しつけられるようになることで、マスク部13が蒸着面に密着する。従って、蒸着の際に、カソード電極パターンAの非蒸着部分に、蒸着材料が入り込むことを防止することができる。また、この場合に、マスク部13は、ある程度の柔らかさをもつ乳剤により形成されているので、蒸着面を傷付けることがない。

【0048】 (第2の実施の形態) 以下、図5を参照して、第2の実施の形態の蒸着用スクリーンマスク40を説明する。なお、本実施の形態においては、マスク部13としてメタルマスク41を用いる以外は、第1の実施の形態と全く同様であり、同様の構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。

【0049】図5に示すように、蒸着用スクリーンマスク40は、スクリーン部12の下側に、所定のパターンを有するメタルマスク41を形成した構成とされている。メタルマスク41は、ニッケル等を含む金属薄膜でたとえばアディティブ法(例えば、メッキ法など)により形成することができる。このメタルマスク41は、前記マスク部13と同様に、スクリーン部12が基板20表面に接触しないように支持する役目も担う。また、メタルマスク41の厚さは、第1の実施の形態と同様に、充分なスクリーンー基板間距離を確保するように考慮されている。

【0050】蒸着用スクリーンマスク40を用いて、カソード電極パターンAを蒸着するときには、第1の実施の形態と同様に、電磁石ステージ21をON状態とし

て、蒸着用スクリーンマスク40を基板20に設置した 状態で、蒸着材料を照射する。次いで、蒸着用スクリーンマスク40を基板20上から外すことで、メタルマスク41の反転パターンを有するカソード蒸着パターンA が形成される。

【0051】以上の第2の実施の形態の蒸着用スクリーンマスク10によれば、メタルマスク41は、金属材料から形成されているので、例えば、乳剤などを用いた場合と比較して、耐熱性を向上することができる。従って、カソード電極パターンAの蒸着の際のプロセス温度を向上することができる。

【0052】なお、本発明は上記実施の形態に限定されるものではない。例えば、本発明の蒸着用スクリーンマスク10、40で製造される有機EL素子の具体的な構成は、本実施の形態で示した構成に限られず、様々な構成に変更可能であることは勿論である。その他、カソード電極の構成や材質など、具体的に示した細部構成および方法は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、適宜に変更可能であることは勿論である。

[0053]

【発明の効果】請求項1記載の蒸着用スクリーンマスク によれば、スクリーン部が磁性材料を含むので基板上に スクリーンマスクにより所定のパターンの薄膜を蒸着に より形成する際に、電磁石を有するステージに基板を載 置することでスクリーン部がマスク部の第1開口部及び 隔壁を介して基板側に引きつけられるためにマスク部を 基板に押しつけることができるのでマスク部と基板との 密着性が増し、隔壁と基板の隙間から蒸着材料が入り込 むことを防止して高精細な薄膜のパターニングが可能と 30 なる。このスクリーンマスクは再利用できるので、蒸着 する度にマスク部と同じ形状のマスクをフォトリソ工程 により形成する必要がないので低コストで且つ高スルー ブットで蒸着を行うことが可能となる。また、蒸着膜 は、マスク部によりスクリーン部と基板との距離があけ られているので、スクリーン部のメッシュ形状の影響を 受けずに、均一かつ連続した膜として形成することがで きる。また、形成した蒸着膜と、スクリーンとが接触し たりすることがない。

【0054】請求項2記載の蒸着用スクリーンマスクによれば、請求項1と同様の効果を奏することができるとともに、マスク部は、感光性材料によりパターニングが可能であることから、微細なパターンの形成も容易である。また、露光・現像してパターニングされた感光性材料は、通常、ある程度の柔軟性を持っており、マスク部の下面と基板表面とが密着した場合においても、蒸着面に傷などを付けたりすることがない。

【0055】請求項3記載の蒸着用スクリーンマスクによれば、請求項1と同様の効果を奏することができるとともに、マスク部が金属材料から形成されているので、50 ある程度の耐熱性を確保することができ、プロセス温度

の上限を高くすることができる。

【0056】請求項4記載の蒸着用スクリーンマスクに よれば、請求項1~3と同様の効果を奏することができ るとともに、マスク部はスクリーン部に支持されるの で、マスク部を微細パターンに形成することも容易であ る。

【0057】請求項5記載の蒸着方法によれば、請求項 1~4に記載の蒸着用スクリーンマスクと同様の効果を 奏することができるとともに、マスク部で仕切られた蒸 着されるべき部分に、蒸着材料が充分に供給され、均一 10 ステージ21に設置した状態を示す図面である。 で連続した蒸着膜を、好適に得ることができる。

【0058】請求項6記載の蒸着方法によれば、請求項 5と同様の効果を奏することができるとともに、さらに 好適に、所定のパターンの蒸着膜を形成することができ る。

【0059】請求項7記載の蒸着方法によれば、請求項 4に記載の蒸着用スクリーンマスクと同様の効果を奏す ることができるとともに、マスク部は基板に密着してい るので、マスク部下面と基板との間に、蒸着材料が入り 込むこともなく、所定のパターンに蒸着膜を形成すると 20

【0060】請求項8記載の有機EL素子の製造方法に よれば、請求項5~7に記載の蒸着方法と同様の効果を 奏することができるとともに、第一電極と第二電極と有 機EL層と等からなり、かつ、少なくとも第二電極がパ* * ターニングされた有機EL素子を、好適に製造すること ができる。

[0061]

(8)

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用した第1の実施の形態の蒸着用ス クリーンマスク10の構成を示す図面である。

【図2】図1の蒸着用スクリーンマスク10を基板側か ら眺めた平面図である。

【図3】図1の蒸着用スクリーンマスク10を、電磁石

【図4】図1の蒸着用スクリーンマスク10を用いて、 カソード電極を蒸着する様子を示す図面である。

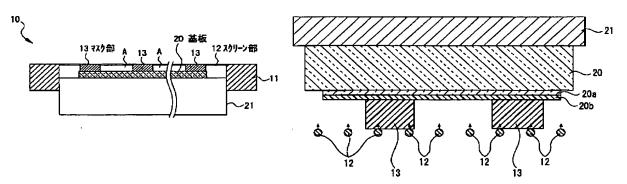
【図5】本発明を適用した第2の実施の形態の蒸着用ス クリーンマスク40の構成を示す図面である。

【符号の説明】

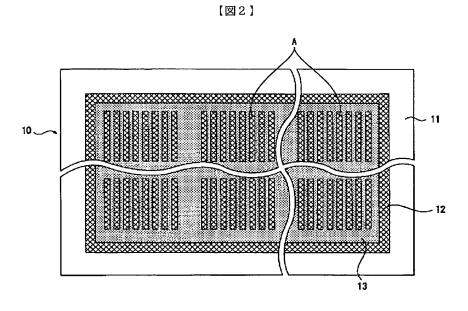
- 10 蒸着用スクリーンマスク
- 12 スクリーン部
- 13 マスク部
- 20 基板
- 20a アノード電極(第一電極)
- 20b 有機EL層
- 20c カソード電極(第二電極)
- 30 蒸着ポート(照射源)
- 40 蒸着用スクリーンマスク

【図1】

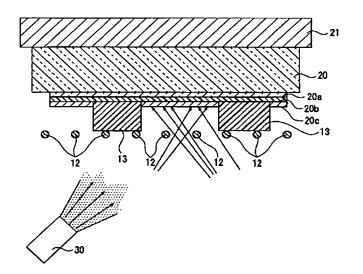
【図3】



(9)



[図4]



【図5】

